

## BQ79716B-Q1 功能安全合规型汽车类 16 节串联电池监测器

### 1 特性

- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性：
  - 器件温度等级 1：-40°C 至 +125°C 环境温度工作温度范围
  - 器件 HBM ESD 分类等级 2
  - 器件 CDM ESD 分类等级 C1
- 符合功能安全标准
  - 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
  - 系统可满足 ASIL D 级要求
  - 硬件可满足 ASIL D 要求
- 每个器件可测量 9 至 16 节串联电池，最多可堆叠 64 个器件
- 专用 ADC，典型精度为  $\pm 1\text{mV}$
- 电芯电压和电池包电流测量同步至  $64\ \mu\text{s}$
- 支持完全冗余的跛行回家模式
- 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
- 支持汇流条而不影响测量精度
- 12 个用于温度传感器/模拟/数字/I<sup>2</sup>C 控制器/SPI 控制器的 GPIO
- 内部电芯均衡
  - 300mA 时达到平衡
  - 用户控制型 PWM 调节电芯平衡电流
  - 内置平衡热管理，具有自动暂停和恢复控制功能
- 稳健的菊花链通信和支持环形架构
- 主机的硬件复位可在不移除电池的情况下模拟类似 POR 的事件
- 支持变压器和电容隔离
- 用于一次自定义编程的片上存储器
- 低功耗模式电流  $< 6\ \mu\text{A}$
- 与具有 SPI/UART 接口的 BQ79600-Q1 兼容

### 2 应用

- 混合动力和电动动力总成系统中的电池管理系统 (BMS)
- 带有电池管理系统的储能电池组

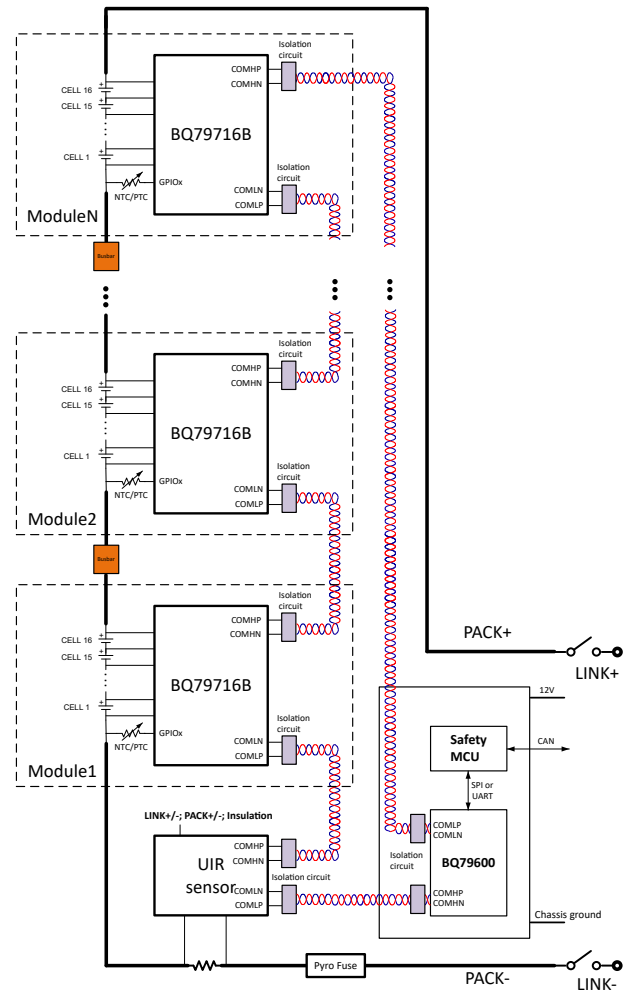
### 3 说明

BQ79716B-Q1 可对 xEV/EV 的高压电池管理系统中高达 16 节串联的电池模块提供高精度的电芯电压测量。该监测器在同一封装类型中提供不同的通道选项，同时提供引脚对引脚兼容性，并支持在任何平台上高度重复使用既有的软件和硬件。该器件具有非常先进的 ADC 架构/测量系统，可满足严格的汽车标准和安全要求。该器件专为 xEV 动力总成中的集中式或分布式架构设计，通过变压器 (或电容器) 实现菊花链隔离。

#### 封装信息

器件型号	封装 (1)	本体尺寸 (标称值)
BQ79716B-Q1	HTQFP (64 引脚)	10.00mm × 10.00mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。



简化版系统图



## 4 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

### 4.1 器件支持

#### 4.1.1 第三方产品免责声明

TI 发布的与第三方产品或服务有关的信息，不能构成与此类产品或服务或保修的适用性有关的认可，不能构成此类产品或服务单独或与任何 TI 产品或服务一起的表示或认可。

### 4.2 文档支持

#### 4.2.1 相关文档

TI mySecure 中提供了以下文档：

- BQ79716B-Q1 功能安全手册
- BQ79716B-Q1 功能安全分析报告摘要
- BQ79716B-Q1 功能安全报告
- LDO NPN 选择应用手册
- 垂直接口通信应用手册
- 浪涌分析应用手册
- 热插拔分析应用手册
- 增强型浪涌抗扰度应用手册

### 4.3 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](https://www.ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

### 4.4 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

### 4.5 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

### 4.6 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

### 4.7 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

## 5 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

## 封装选项附录

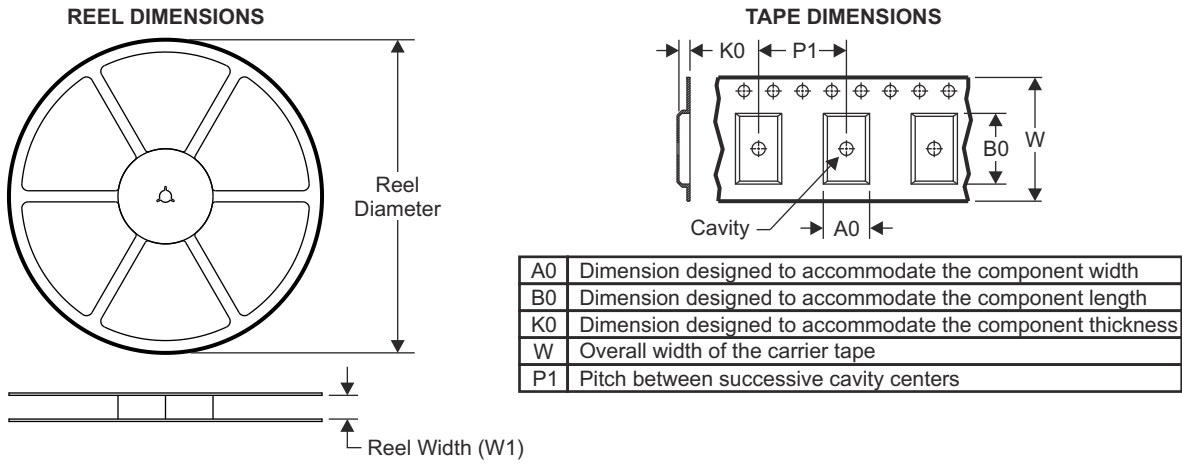
### 封装信息

可订购器件型号	状态	材料类型	封装   引脚	包装数量   包装	RoHS	引脚镀层/焊球材料	MSL 等级/回流焊峰值温度	工作温度 (°C)	器件标识
BQ79716BQPAPRQ1	运行	生产	HTQFP (PAP)   64	1000   卷带包装	是	NiPdAu	MSL-3 260C-168 HR	-40 至 125	BQ79716BQ

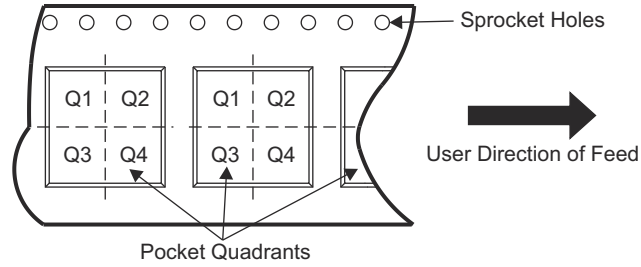
**重要信息和免责声明：**本页面上提供的信息代表 TI 在提供该信息之日的认知和观点。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息，TI 不对此类信息的正确性做任何声明或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息，但是可能尚未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息，因此可能不会公布其 CAS 编号及其他受限制的信息。

在任何情况下，TI 因此类信息产生的责任决不超过 TI 每年向客户销售的本文档所述 TI 器件的总购买价。

### 5.1 卷带包装信息

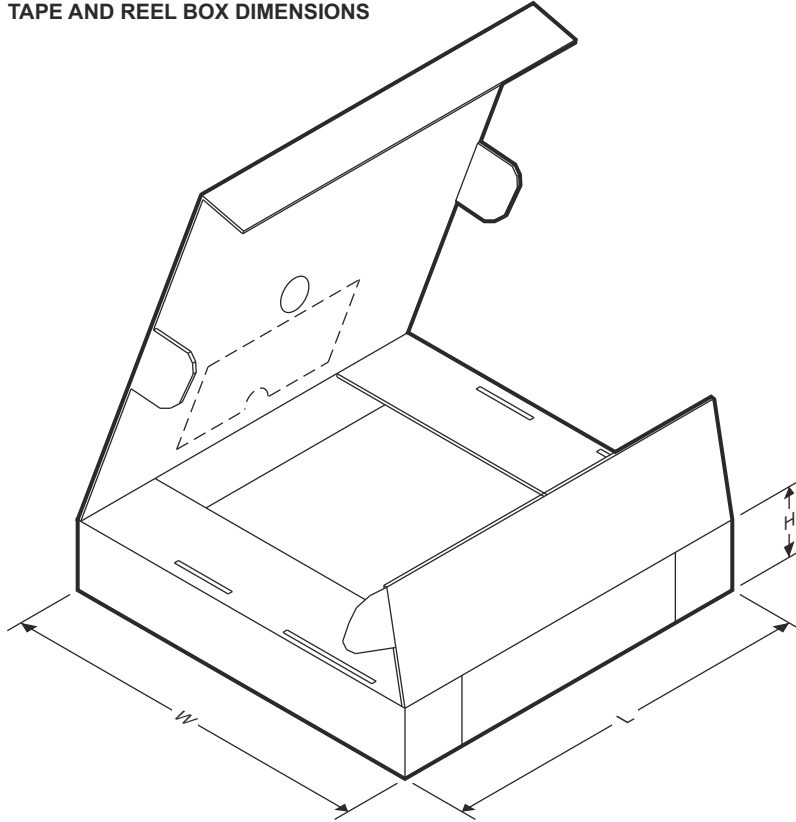


#### QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	卷带直径 (mm)	卷带宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
BQ79716BQPAPRQ1	HTQFP	PAP	64	1000	330.0	24	13	13	1.5	16.0	24.0	Q2

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



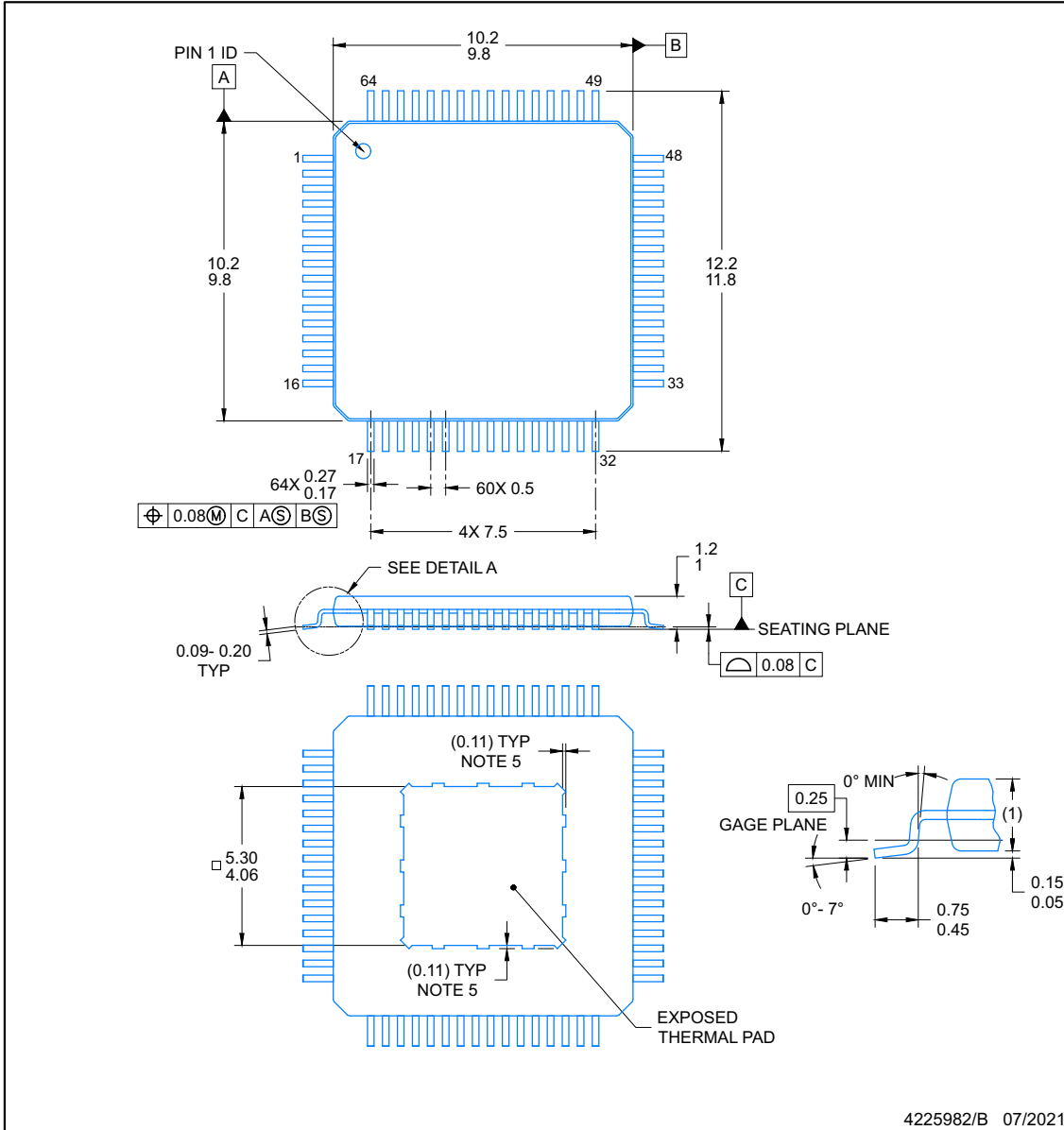
器件	封装类型	封装图	引脚	SPQ	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)
BQ79716BQPAPRQ1	HTQFP	PAP	64	1000	367.0	367.0	55.0

5.2 机械数据

PAP0064N

PACKAGE OUTLINE  
HTQFP - 1.2 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK



NOTES:

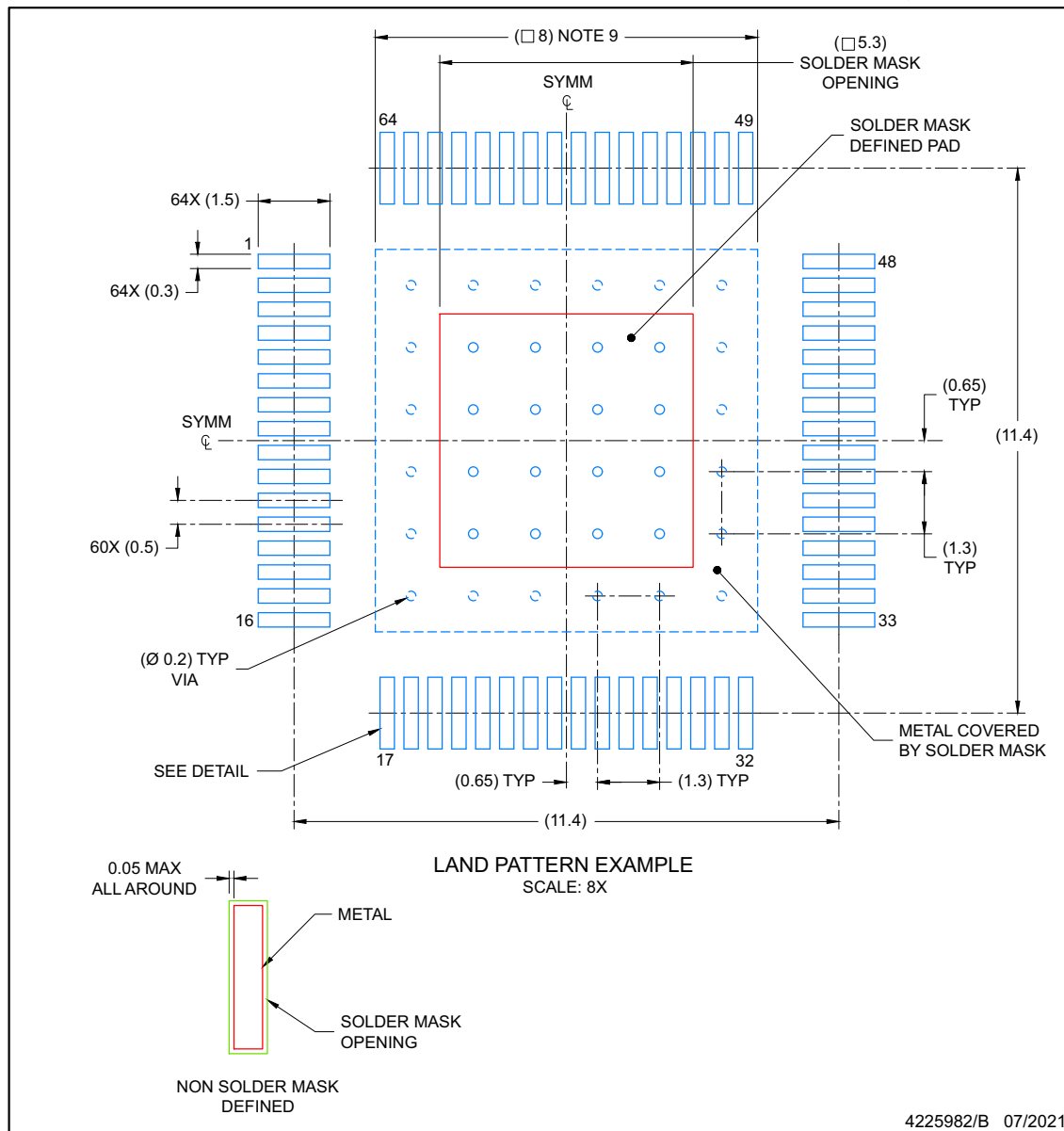
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Body length does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 per side.
4. Body width does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.50 per side.
5. Strap features may not be present.
6. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.

**EXAMPLE BOARD LAYOUT**  
**HTQFP - 1.2 mm max height**

**PAP0064N**

PLASTIC QUAD FLATPACK



NOTES: (continued)

7. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
8. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
9. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. Refer to technical brief, PowerPAD Thermally Enhanced Package, Texas Instruments Literature No. SLMA002 (www.ti.com/lit/slma002) and SLMA004 (www.ti.com/lit/slma004).

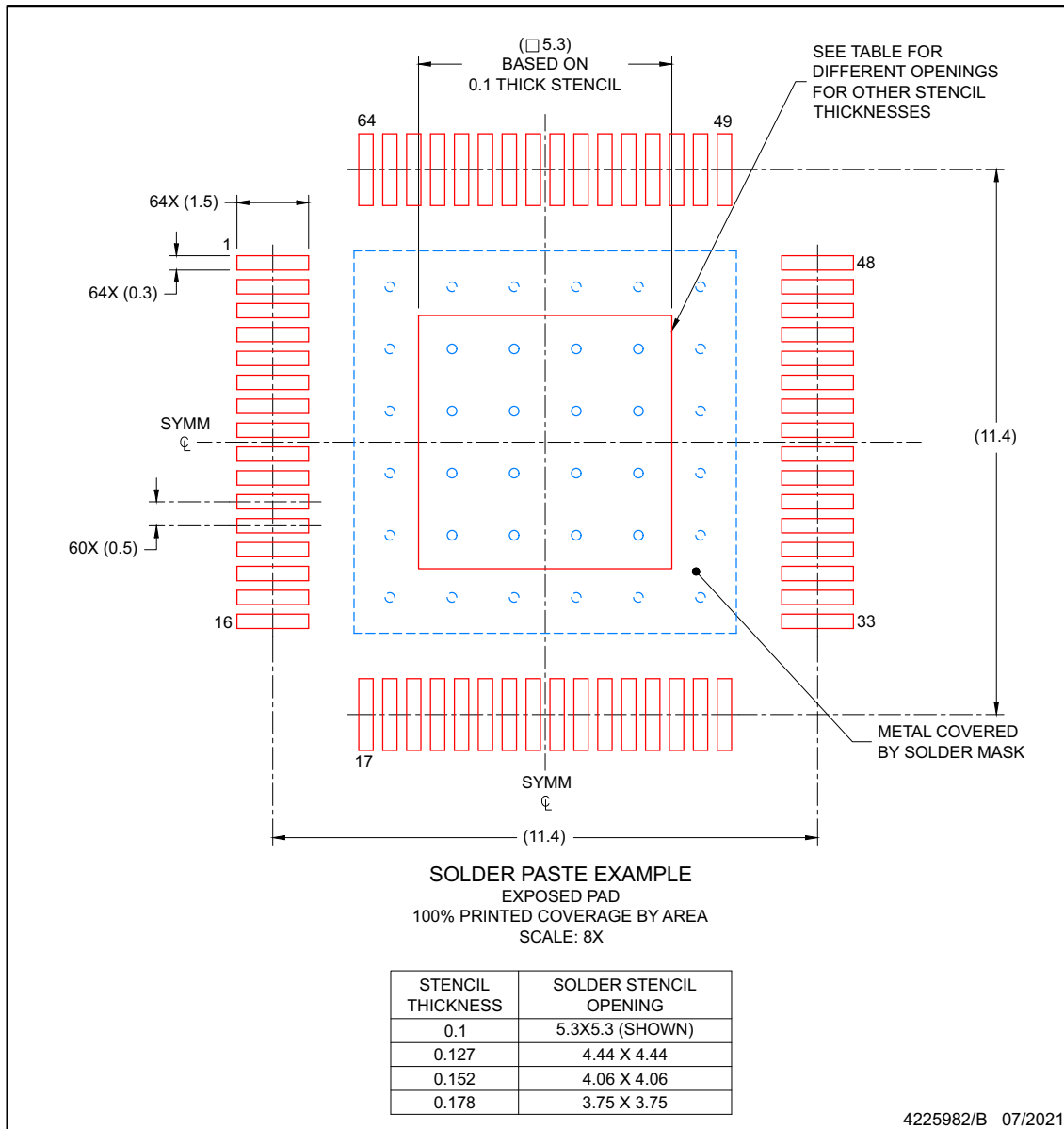


## EXAMPLE STENCIL DESIGN

PAP0064N

HTQFP - 1.2 mm max height

PLASTIC QUAD FLATPACK



NOTES: (continued)

- Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
- Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

**PACKAGING INFORMATION**

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
<a href="#">BQ79716BQPAPRQ1</a>	Active	Production	HTQFP (PAP)   64	1000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-	BQ79716BQ

(1) **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:**The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

## GENERIC PACKAGE VIEW

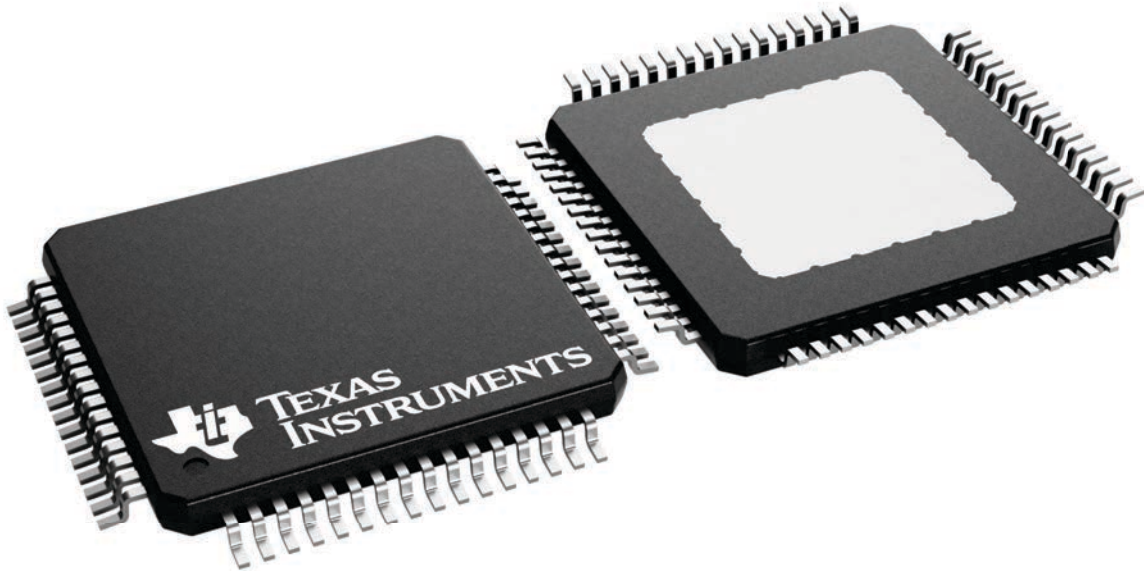
**PAP 64**

**HTQFP - 1.2 mm max height**

10 x 10, 0.5 mm pitch

QUAD FLATPACK

This image is a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.



4226442/A

## 重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月